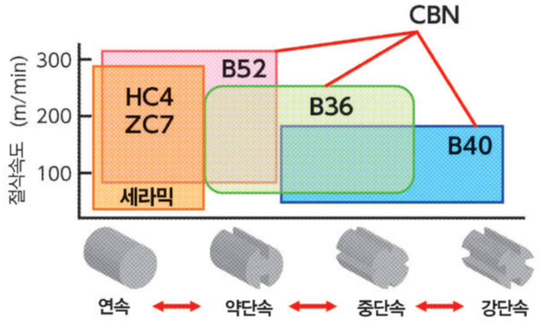
고경도재 가공

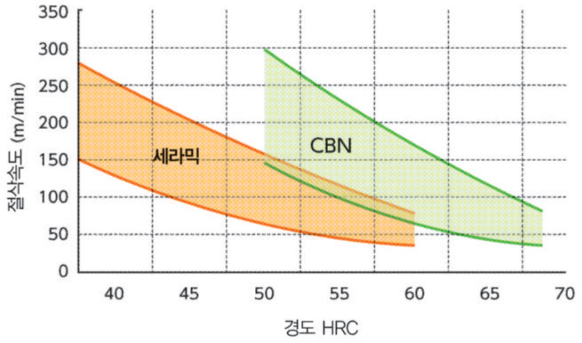
고경도재 가공에 있어서의 NTK 공구 선정 기준

■ 공구 재질 선정



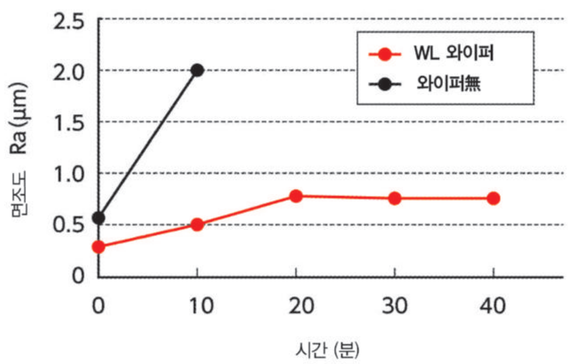
■ 추천 절삭속도

(경도별 추천 절삭속도 (연속가공))



■ 와이퍼 효과

CNGA120412WL v_c=100m/㎜ f=0.1㎜/rev a_p=0.5㎜

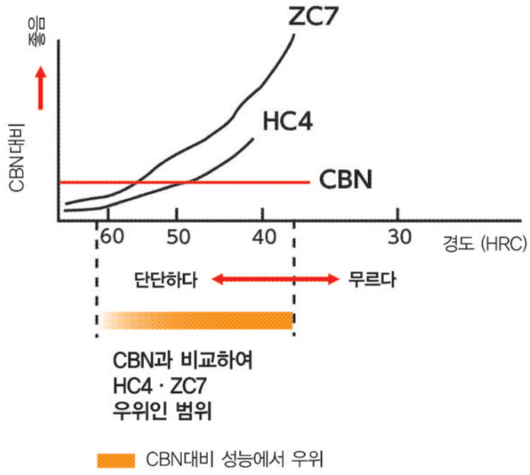


■ 추천 절입량과 이송량

【코너R 사이즈별 추천 절입량과 이송】

코너R	절입량 (㎜)	이송 (㎜ /rev)
R0.4	0.15	0.05 ~ 0.08
R0.8	0.3	0.08 ~ 0.10
R1.2	0.4	0.10 ~ 0.13
R1.6	0.5	0.13 ~ 0.16
R6.35	2.0	0.16 ~ 0.25

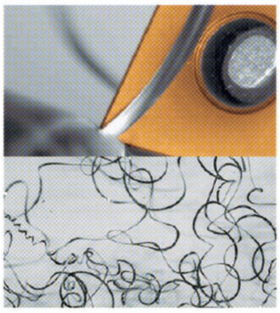
■ 세라믹의 우위성



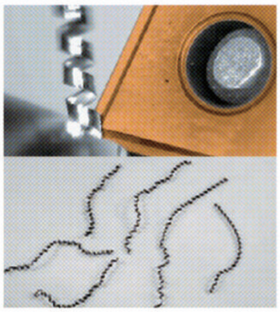
■ 칩 처리

세라믹 공구 "ZC7"에 "AG 브레이커"를 채용하여
칩 처리문제에 의한 가공면 불량이나 기계정지가
개선되어 장시간 가동이 가능하게 됩니다.

브레이커 無



AG 브레이커



피삭재 : SCM415 침탄열처리 HRC50
사용팁 : ZC7 CNGA(G)120408
v_c=150m/㎜ f = 0.2㎜/rev a_p= 0.2㎜

A 신제품
B 공구재종·선택가이드
C CBN·세라믹·PCD
D 초경자립
E 표준팁·재고일람
F 외경
G SS바이트·소형자동
H 홈가공
I 나사가공
J 세이퍼
K 내경·보링바
L 오리지널툴
M 엔드밀
N 스로어웨이드릴
O 밀링커터
P 기술자료
Q 색인